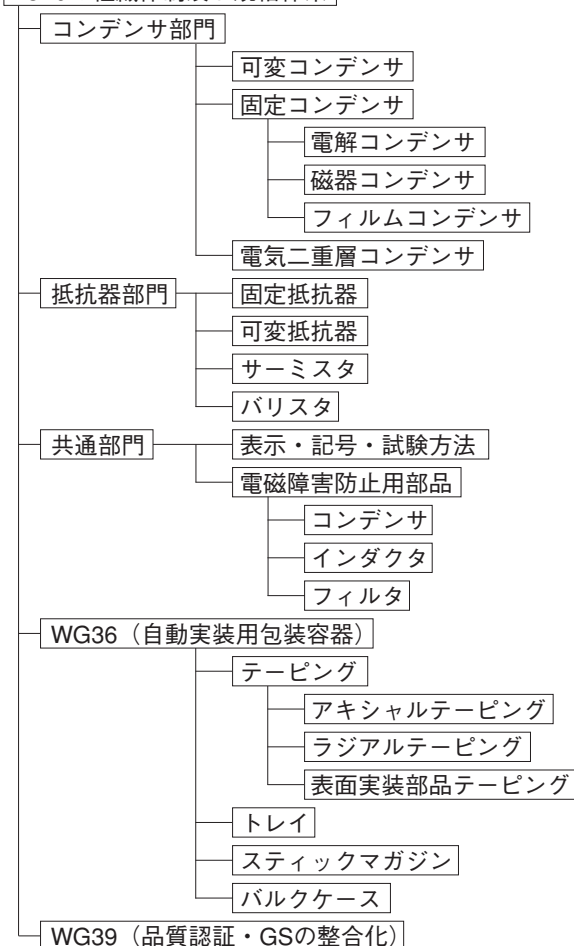


IEC TC40フィンランド・ヘルシンキ会議報告

TC40の概要

TC40（電子機器用コンデンサ及び抵抗器）は、電子部品の5つの小委員会の親委員会として、1954年に設立されました。その後、取り扱う品目が広いため、実質審議メンバに配慮し、三部門に再整理されました。しかし、TC40内規格の整合化のため、サブコミティ（SC）を設置しておらず、同じ時期・場所で、全体会議を開催しています。

TC40の組織体制及び規格体系



ヘルシンキ会議の議題と討議結果

今回のIEC TC40会議は、フィンランド・ヘルシンキ市にて、2007年6月18日から21日までに、全体会議のほか、二つのWG、二つのメンテナンスチームの会議が開催されました。このほか、一つのメンテナンスチームは、前の週にドイツにて事前会合を開催しています。

この会議には、開催国のフィンランドに加え、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、スウェーデン、ベルギー、韓国及び日本の11ヶ国32名が参加しました。

日本からは、村田製作所、日本ケミコン、KOA、ニチコン、ルビコン、太陽誘電、パナソニックエレクトロニックデバイス、岡谷電機、松下電器産業及び住友スリーエムの10社12名が参加しています。

会議の主な議題は、次のとおりです。

(a) WG36（自動実装容器包装）会議

日本から、部品寸法0402（単位：mm）などの極小部品に対応する包装形態の新規2提案を行っており、文書がCDV段階にありましたが、より詳細な掲載を求められたため、コメントに沿って修正し、2ndCDVを発行することになりました。完全に日本が先行している分野です。

上記を含めた表面実装部品（SMD）の再構築規格案は、上記の内容がまとまった段階で見直すことになりました。

また、半導体デバイスを取納するトレイの一部寸法の修正提案を行い、その通りだとして賛意が得られました。

(b) WG39（品質認証+GS間の整合化）

IEC伊・フィレンツェ総会の決議に基づき、品質認証事項を本文では最小限度にし、附属書Q（参考）に移す作業を行ってきました。その際、各品目別通則間で少し違いがあったため、品質事項を含めた各項目の見直しの最終確認を行い、方向付けを行いました。附属書Qには、技術認証（TA）を追加することとなりました。



写真 1. TC40/WG36 meeting その1

(社)電子情報技術産業協会 電子部品部会 標準化委員会 受動部品標準化専門委員会



写真 2 . TC40/WG36 meeting その2



写真 4 . Welcome party その1



写真 3 . TC40 Plenary meeting



写真 5 . Welcome party その2

(c) MT60115-1/-8 (固定抵抗器／表面実装抵抗器)

ドイツから、宇宙、自動車などの特殊用途を含める提案があり、前週に3日間に渡り日独で調整しましたが、明確な結論に至らず、全体会議での結論に委ねました。

(d) MT60384-1 (固定コンデンサ)

日独コメントの調整を行い、基本的な合意ができたため、FDISを作成し、投票に回すことになりました。

(e) MT60384-14 (電磁障害防止用コンデンサ)

ULの規定内容を取り入れる背景があり、定格電圧範囲をモータ制御用に用いるため、1,000Vまで定格電圧を拡大すること並びに部品の耐炎性及び発炎性を強化する提案がありました。基本的に合意しましたが、回送されるCD文書で審議することになりました。

(f) 全体会議 (コンデンサ及びフィルタ部門並びに抵抗器及び共通部門)

各WG及びMT報告、日本提案の低ESL測定方法などTC40文書全体の進捗の確認があり、承認されました。

日本から、IEC規格と各国の国家規格 (または地域規格) との整合化状況を提案し、日本の実態を公表し

ました。同様に、欧州のEN規格との整合化状況も報告されました。今後、米国、中国、韓国などの状況が報告されることになっています。

日本のJARI (日本電気自動車研究所) から、TC69 (電気自動車) へ、ハイブリッドEV用EDLCの試験方法 (JEITAとタイアップ) が10月頃提案される旨その概要の報告がありました。TC69からのリエゾン提携の申し入れがあった場合には、受け入れることが承認されています。

また、2008年3月までに、リード端子形のアルミニウム固体 (導電性高分子) コンデンサの新規提案を行うこと及びその概要が説明されました。なお、2007年IEC1906賞には、近藤委員長及び青木幹事が内定したことが公表されました。

最後に、2008年は、日本の札幌にて開催予定の旨公表し、参加者から好意で迎えられました。

今回の開催地であるヘルシンキは、一歩足を伸ばすと、のどかな風景が飛び込んでくる非常に風光明媚な都市です。会議終了後、海にほど近い場所でWelcome partyが開催されました。